

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 21 年 6 月 18 日 (2009.6.18)

【公開番号】特開 2006-324665 (P2006-324665A)
 【公開日】平成 18 年 11 月 30 日 (2006.11.30)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-047
 【出願番号】特願 2006-136747 (P2006-136747)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 25/10 (2006.01)

H 0 1 L 25/11 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 5 月 1 日 (2009.5.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

オフセット集積回路パッケージオンパッケージ積層システムであって、
 ベース基板を設けることと、
 コンタクトパッドを前記ベース基板上に形成することと、
 第 1 の集積回路を前記ベース基板上に取付けることと、
 ベースパッケージ本体を前記第 1 の集積回路を囲むように形成することと、
 オフセット基板を設けることと、
 第 2 の集積回路を前記オフセット基板上に取付けることと、
 前記ベース基板の上面の一部が露出するように、前記オフセット基板を前記ベースパッケージ本体の一部のみの上に置くことを含む、前記オフセット基板を前記コンタクトパッドに結合することとを備える、システム。

【請求項 2】

受動構成要素、能動構成要素、またはそれらの組合せを前記ベース基板に取付けることをさらに含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの角にある状態で、前記オフセットパッケージを前記ベース基板に取付けることをさらに含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記ベースパッケージ本体と前記オフセット基板との間に隙間充填接着剤を与えることをさらに含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 5】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの 1 つの端縁と整列された状態で、前記オフセットパッケージを前記ベース基板上に取付けることをさらに含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

オフセット集積回路パッケージオンパッケージ積層システムであって、
 ベース基板と、

前記ベース基板上に形成されるコンタクトパッドと、
前記ベース基板上に取付けられる第１の集積回路と、
前記第１の集積回路を囲むように成形されるベースパッケージ本体と、
オフセット基板と、
前記オフセット基板上に取付けられる第２の集積回路と、
前記ベース基板の上面の一部が露出するように、前記ベースパッケージ本体の一部のみの上に置かれる前記オフセット基板を含む、前記コンタクトパッドに結合される前記オフセット基板とを含む、システム。

【請求項 ７】

前記ベース基板に取付けられる受動構成要素、能動構成要素、またはそれらの組合せをさらに含む、請求項 ６に記載のシステム。

【請求項 ８】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの角にある状態で前記ベース基板上に取付けられる前記オフセットパッケージをさらに含む、請求項 ６に記載のシステム。

【請求項 ９】

前記ベースパッケージ本体と前記オフセット基板との間に隙間充填接着剤をさらに含む、請求項 ６に記載のシステム。

【請求項 １０】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの１つの端縁と整列された状態で前記ベース基板上に取付けられる前記オフセットパッケージをさらに含む、請求項 ６に記載のシステム。